# 苏州东微半导体股份有限公司

公司代码:688261 公司简称:东微半导

## 2026 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的风险,敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、风险因素"部分,敬请投资者注意投资风险。

1.3 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.4 公司全体董事出席董事会会议。

1.5 本半年度报告未经审计。

1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用√不适用

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所科创板 | 东微半导 | 688261 | 不适用 |

公司存托凭证简况

□适用√不适用

联系人和联系方式

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书(信息披露境内代表) |
|---|---|
| 姓名 | 李麟 |
| 电话 | +86 512 62668198 |
| 办公地址 | 江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道99号纳米城东南区65栋 |
| 电子信箱 | enquiry@orientalsemi.co |

2.2 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 3,371,554,024.73 | 3,119,248,864.05 | 8.09 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,023,827,649.33 | 2,956,604,258.30 | 2.27 |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 736,433,420.21 | 615,831,685.01 | 19.58 |
| 利润总额 | 112,408,030.91 | 22,941,321.24 | 389.98 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 106,301,799.14 | 27,581,423.21 | 285.41 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 689,195.73 | 9,726,962.26 | -92.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -129,303,928.74 | -183,406,220.92 | 不适用 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 3.54 | 0.95 | 增加2.59个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.87 | 0.23 | 278.26 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.86 | 0.23 | 273.91 |
| 研发投入占营业收入的比例(%) | 7.56 | 6.86 | 增加0.70个百分点 |

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末股东总数(户) | 19,364 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 不适用 |
| 截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户) | 不适用 |

前10名股东持股情况

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 包含转融通借出股份的限售股份数量 | 质押、标记或冻结的股份数量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王鹏飞 | 境内自然人 | 12.09 | 14,823,125 | 27,927 | 27,927 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区原点创业投资有限公司 | 国有法人 | 11.39 | 13,963,950 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 龚轶 | 境内自然人 | 9.99 | 12,240,578 | 27,927 | 27,927 | 无 | 0 |
| 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 国有法人 | 5.35 | 6,552,597 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 卢万松 | 境内自然人 | 3.57 | 4,371,284 | 27,927 | 27,927 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 3.32 | 4,071,267 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.11 | 2,591,389 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王爱军 | 境内自然人 | 1.58 | 1,934,688 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投资基金 | 其他 | 1.04 | 1,280,000 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 王绍泽 | 境内自然人 | 0.99 | 1,208,138 | 0 | 0 | 无 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、王鹏飞与龚轶系公司共同实际控制人,苏州工业园区高维企业管理合伙企业(有限合伙)系王鹏飞控制的企业,苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业(有限合伙)系龚轶控制的企业;<br>2、中新苏州工业园区创业投资有限公司及苏州工业园区原点创业投资有限公司同为苏州工业园区经济发展有限公司控制的企业,苏州工业园区原点创业投资有限公司系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司;<br>3、卢万松系公司共同实际控制人王鹏飞和龚轶的一致行动人;<br>4、除上述情况外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用√不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用√不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用√不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用√不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用√不适用

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2026-037

## 苏州东微半导体股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4040号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,844,092股,本次发行价格为每股人民币130.00元,募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元,扣除保荐承销费155,127,216.60元(不含增值税)后的募集资金为2,034,604,743.40元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剔余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后,实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年1月28日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕42号)。

(二)募集资金累计使用金额和结余情况

公司2026年半年度募集资金使用具体情况如下:

募集资金基本情况表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 |
|---|---|
| 募集资金到账时间 | 2022年1月28日 |
| 本次报告期 | 2026年1月1日至2026年6月30日 |
| 项目 | 金额 |
| 一、募集资金总额 | 218,973.20 |
| 其中:超募资金金额 | 106,786.56 |
| 减:直接支付发行费用 | 18,317.54 |
| 二、募集资金净额 | 200,655.66 |
| 减: | |
| 以前年度已使用金额 | 179,222.87 |
| 本年度使用金额 | 19,678.16 |
| 节余募集资金永久补流金额 | 6,975.34 |
| 现金管理金额 | 0 |
| 银行手续费支出及汇兑损益 | 0 |
| 其他-具体说明 | / |
| 加: | |
| 募集资金利息收入净额 | 7,578.91 |
| 其他-具体说明 | / |
| 三、报告期期末募集资金余额 | 2,358.20 |

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下,变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-004)。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2026年6月30日余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000318135 | 938,691,000.00 | | 已注销 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000318288 | 1,095,913,743.40 | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 51549300001103 | | 23,581,989.67 | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801200006972 | | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行 | 512906076910302 | | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州科技支行 | 325060700013000751708 | | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 8112001011868888888 | | | 使用中 |
| 合 计 | | | 2,034,604,743.40 | 23,581,989.67 | / |

注:初始存放金额与前次发行募集资金净额的差异系与发行费相关的其他外部费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)截至2026年6月30日,公司前次募集资金使用情况对照表请详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)超募资金永久补流情况:

2023年4月18日,公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2023年5月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-013)。

2024年4月25日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议并通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2024年5月20日召开的公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金30,000.00万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的28.09%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-017)。

公司于2025年4月25日召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金30,000.00万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的28.09%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-016)。

公司于2026年4月24日召开了第二届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2026年5月20日召开的公司2025年年度股东会审议通过,同意公司本次用于永久补充流动资金的金额不超过19,700.00万元,占超募资金总额的比例为18.45%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-013)。

截至2026年6月30日,公司累计使用超募资金永久补充流动资金的金额为109,678.16万元。

(三)关于前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明如下:

1、超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目

该项目实际投资金额20,639.92万元,募集后承诺投资金额20,414.58万元,实际投资总额超出承诺投资金额225.34万元,超出金额系闲置募集资金在存放期间所产生的利息收入净额和理财产品收益。

2、新结构功率器件研发及产业化项目

该项目实际投资金额10,105.71万元,募集后承诺投资金额10,770.32万元,实际投资总额低于承诺投资金额664.61万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理制度》相关规定,节余募集资金(包括利息收入)用作其他用途,金额低于1,000万元的,可以豁免履行审议披露程序。公司已将该项目结余资金转入公司自有资金账户,用于永久补充流动资金。

3、研发工程中心建设项目

该项目实际投资金额11,982.18万元,募集后承诺投资金额16,984.20万元,实际投资总额低于承诺投资金额5,002.03万元。研发工程中心建设项目的差异主要来源于项目实施过程中,公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定,秉持节约、合理、高效的原则,在保障项目质量并有效控制实施风险的前提下,加强各环节费用的管控与监督,通过对各项资源的合理调度与优化配置,有效降低了项目建设成本与费用支出,从而形成资金节余。公司于2025年9月30日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目之"研发工程中心建设项目"已于彼时达成预定可使用状态,同意予以结项。为提高募集资金使用效率,优化资源配置,提升公司经营效益,公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

4、科技与发展储备资金

该项目实际投资金额43,893.20万元,募集后承诺投资金额45,700.00万元,实际投资总额低于承诺投资金额的原因系项目尚未结项,后续达仍将投入资金。

截至2026年6月30日,超募资金总额106,786.56万元已全部使用完毕,其中2,601.86万元用于回购股份,109,678.16万元用于永久补充流动资金。实际投资总额超出承诺投资金额5,493.46万元,超出金额为闲置募集资金在存放期间所产生的利息收入净额和理财产品收益。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2026年6月30日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

(一)对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

截至2026年6月30日,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

(二)前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年6月27日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币8,241.35万元(其中项目预先投入5,656.52万元,发行费用2,584.83万元)。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司该情况进行了审验,并出具了《鉴证报告》(天健审〔2022〕7317号)。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至2026年6月30日,前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成,具体置换情况如下:

单位:万元

| 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金计划使用金额 | 以自筹资金预先投入金额 | 置换金额 |
|---|---|---|---|---|
| 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目 | 20,414.58 | 20,414.58 | 4,668.76 | 4,668.76 |
| 新结构功率器件研发及产业化项目 | 10,770.32 | 10,770.32 | 987.76 | 987.76 |
| 合计 | 31,184.90 | 31,184.90 | 5,656.52 | 5,656.52 |

五、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表请详见附表2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目

基于公司深槽超级结技术以及屏蔽栅技术的丰富积累,对高压超级结MOSFET产品及中低压屏蔽栅MOSFET产品的设计及工艺技术等方面进行改进和提升。该项目的效益反映在公司的超级结与屏蔽栅功率器件整体经济效益中,无法单独核算。

2、新结构功率器件研发及产业化项目

拟推出的新产品主要涉及Tri-gate结构IGBT器件设计及其工艺技术、Super-Silicon超级硅MOSFET设计及其工艺技术及Hybrid-FET器件及其制造技术。其中,IGBT产品是在公司原创的Tri-gate结构IGBT器件设计及其工艺技术的基础之上进一步提高开关速度性能的产品,适用于频率更高的电路场合;超级硅功率器件是公司在原创的超级硅器件技术之上进一步优化升级诞生的产品,适用于超高频率的电路场合,可实现接近GaN、SiC功率器件的效率;新一代高速大电流功率器件采用公司原创的Hybrid-FET器件技术,在大幅提高功率器件功率密度的同时,维持较高的开关速度。该项目的效益反映在公司的新结构功率器件整体经济效益中,无法单独核算。

3、研发工程中心建设项目

有助于提升公司创新水平和效率,营造良好的实验环境,吸引高端技术人才的加入,加快科研成果转化,为公司的可持续发展提供更有力的技术支撑,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

4、科技与发展储备资金项目

将有效增强公司的经营能力和研发能力,提高公司的偿债能力,降低公司的流动性风险及经营风险,从而提高公司的市场竞争力,但无法直接产生收入,故无法单独核算效益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2026年6月30日,公司不存在前次募集资金用于资产认购股份的资产运行情况。

七、闲置募集资金情况说明

公司于2022年2月28日召开了公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币150,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用,到期后将归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-003)。

公司于2023年2月25日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币145,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年2月27日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-003)。

公司于2024年2月22日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币100,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年2月24日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-005)。

公司于2025年2月20日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币67,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年2月22日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-006)。

公司于2026年2月12日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下,使用额度最高不超过人民币21,900万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)的投资产品(包括但不限于结构性存款、大额存单等),使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2026年2月13日在上海证券交易所网站披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-001)。

截至2026年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理均已全部赎回。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日,公司前次募集资金净额200,655.66万元,实际使用募集资金198,901.03万元,考虑闲置资金现金管理收益、已完结项目剩余募集资金补流的情况,尚未使用募集资金2,358.20万元,尚未使用募集资金占前次募集资金净额的1.18%。

(一)未使用完毕的原因

未使用完毕的项目均系科技与发展储备资金项目,该项目细分产业并购与补充流动资金。其中,产业并购及整合项目投资范围为汽车级功率器件设计、SiC功率器件设计以及模块设计应用等方向投资并购国内外优质企业。目前公司正围绕上述方向持续寻源,尚需一定时间推进落实,故该部分募集资金暂未使用完毕。

(二)剩余资金的使用计划和安排

公司将持续围绕汽车级功率器件设计、SiC功率器件设计以及模块设计应用等方向推进相关工作,并根据项目进展及时合规使用募集资金。

九、前次募集资金使用的其他情况

公司分别于2023年9月19日、2023年10月9日召开了第一届董事会第十九次会议、2023年第二次临时股东大会,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股票。本次回购的资金总额不低于人民币2,500万元(含)且不超过人民币5,000万元(含),回购价格不超过人民币140元/股(含),回购的股份将在未来适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划。回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

截至2024年9月13日,公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为434.857股,占公司总股本的0.3549%,购买的最高价格为90.70元/股,最低价格为29.66元/股,合计支付的总金额为人民币26,018,132.75元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。具体内容详见公司于2024年9月19日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》(公告编号:2024-035)。

截至2026年6月30日,除上述回购事项外,公司不存在前次募集资金使用的其他情况。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026年8月20日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位:万元 币种:人民币

| 发行名称 | 2022年首次公开发行股份 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 募集资金到账日期 | 2022年1月28日 | | | | | | | | | | | |
| 本年度投入募集资金总额 | 19,678.16 | | | | | | | | | | | |
| 已累计投入募集资金总额 | 198,901.03 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 募投项目性质 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)=(4)(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期(按具体月份) | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目 | 研发项目 | 否 | 20,414.58 | 20,414.58 | 20,414.58 | | 20,639.92 | 225.34 | 101.10 | 2023年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 新结构功率器件研发及产业化项目 | 研发项目 | 否 | 10,770.32 | 10,770.32 | 10,770.32 | | 10,105.71 | -664.61 | 93.83 | 2024年7月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发工程中心建设项目 | 研发项目 | 否 | 16,984.20 | 16,984.20 | 16,984.20 | | 11,982.18 | -5,002.03 | 70.55 | 2025年8月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 科技与发展储备资金 | 其他 | 否 | 45,700.00 | 45,700.00 | 45,700.00 | | 43,893.20 | -1,806.80 | 96.05 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | | 93,869.10 | 93,869.10 | 93,869.10 | | 86,621.01 | -7,248.09 | 92.28 | — | - | - | - |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | |
| 永久补充流动资金 | | 否 | - | 104,184.70 | 104,184.70 | 19,678.16 | 109,678.16 | 5,493.46 | 105.27 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 回购股份 | | 否 | | 2,601.86 | 2,601.86 | | 2,601.86 | | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | | - | 106,786.56 | 106,786.56 | 19,678.16 | 112,280.03 | 5,493.46 | 105.14 | - | - | - | - |
| 合计 | | | 93,869.10 | 200,655.66 | 200,655.66 | 19,678.16 | 198,901.03 | -1,754.63 | | | — | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(四)对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况" | | | | | | | | | | | | |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 详见本专项报告"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况" | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4:"回购股份"行所有数据均包含手续费佣金及证券回购账户的利息收入。

证券代码:688261 证券简称:东微半导 公告编号:2026-038

## 苏州东微半导体股份有限公司前次募集资金使用情况报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定,苏州东微半导体股份有限公司(以下简称"公司")于2026年8月19日召开第二届董事会2026年第二次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十九次会议和第二届董事会第二十六次会议,分别审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》,现将公司截至2026年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一)前次募集资金金额及资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕4040号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票16,844,092股,本次发行价格为每股人民币130.00元,募集资金总额为人民币2,189,731,960.00元,扣除保荐承销费155,127,216.60元(不含增值税)后的募集资金为2,034,604,743.40元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年1月28日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除剔余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用28,048,153.30元后,实际募集资金净额为人民币2,006,556,590.10元。上述募集资金已于2022年1月28日全部到位,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,于2022年1月28日出具了《验资报告》(天健验〔2022〕42号)。

(二)前次募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司按照有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司已于2022年1月与保荐机构中国国际金融股份有限公司、宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

2022年2月28日,公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议,审议并通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》,同意公司在不改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的前提下,变更部分募集资金专项账户。公司和保荐机构中国国际金融股份有限公司于2022年2月28日分别与中信银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、交通银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、苏州银行股份有限公司工业园区支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

具体内容详见公司于2022年3月2日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于变更部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2022-004)。

上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2026年6月30日,公司募集资金在银行账户的存放情况如下:

单位:人民币元

| 账户名称 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2026年6月30日余额 | 账户状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000318135 | 938,691,000.00 | | 已注销 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 75250122000318288 | 1,095,913,743.40 | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 苏州银行股份有限公司工业园区支行 | 51549300001103 | | 23,581,989.67 | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 89010078801200006972 | | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行 | 512906076910302 | | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 交通银行股份有限公司苏州科技支行 | 325060700013000751708 | | | 使用中 |
| 苏州东微半导体股份有限公司 | 中信银行股份有限公司苏州工业园区支行 | 8112001011868888888 | | | 使用中 |
| 合 计 | | | 2,034,604,743.40 | 23,581,989.67 | / |

注:初始存放金额与前次发行募集资金净额的差异系与发行费相关的其他外部费用。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)截至2026年6月30日,公司前次募集资金使用情况对照表请详见本报告附表1《前次募集资金使用情况对照表》。

(二)超募资金永久补流情况:

2023年4月18日,公司召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十二次会议,审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2023年5月18日召开的公司2022年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超额募集资金人民币30,000.00万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的比例为28.09%。公司承诺每12个月内累计使用超募资金用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%,在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行。具体内容详见公司于2023年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2023-013)。

2024年4月25日,公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议,审议并通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》,并经2024年5月20日召开的公司2023年年度股东大会审议通过,同意公司使用部分超募资金30,000.00万元用于永久补充流动资金,占首次公开发行股票超募资金总额的28.09%。